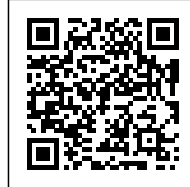


**FEEDING EQUIPMENT  
DIE EJECT UNIT (MANUELL)**

Artikelnummer: S3-0087  
23.400,00 € exkl. MwSt.



---

Kategorien: [Materialzuführung](#), [Module](#)

## BESCHREIBUNG

Die manuelle Die Eject Unit löst mit ihrem Nadelsystem die auf Folie fixierten Bauteile zur Übergabe an das Bestückungssystem. Durch Austausch des manuell wechselbaren Nadelsystems und des Wafer-Frame-Adapters werden unterschiedlichste Bauteile aus bis zu 8 Zoll großen Wafern verarbeitet. Die Geschwindigkeit der Ausstechnadeln ist auf das Bestückungssystem synchronisiert und bauteilspezifisch wählbar.

Der adaptierte Wafer wird manuell auf die Einheit aufgesetzt. Die Die Eject Unit (manuell) wurde speziell für die OurPlant D1 konzipiert.

Die Die Eject Unit ist inklusive einem Nadelhalter mit Deckel und Nadel (Nadel-Vakuum-System) und einem Waferadapter (wählbar). Durch spezielle, optionale Adaptierungen können auch Waffle-Packs auf dem Modul verarbeitet werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen in mm (B x T x H)	335 x 418 x 138
Gewicht in kg	10
Max. Wafergröße in Zoll / mm	8 / 200
Hub des Nadelsystems in mm	6
Spannung in V	24

**Max. Stromstärke in A**

3

**Kommunikation**

UNICAN

